

Anchor[®]

HSP[®]

異質性平面拋光砂輪 Heterogeneous Surface Polishing

IC Board、PLP、FOPLP等精密高效拋光減薄

高效移除、不沾黏、面粗優



IC載板依材料及製程可分為ABF、BT以及MIS，其部分製程是以環氧樹脂為主要模封材料，再將銅導線以電鍍方式建佈在每一模封層上(如下圖)。研磨過程中，砂輪會同時接觸到環氧樹脂與銅導線等複合材料。



除了上述載板製程之研磨加工，嘉寶HSP砂輪也針對EMC封裝(Epoxy Molding Compounds)、PLP研磨(面板級封裝)及FOPLP研磨(扇出型面板級封裝)等應用加工，提供各式解決方案。目前加工實績包含：**純銅**、**銅+EMC**、**ABF+銅**、**BT+銅**、**EMC+Chip**以及**Invar**等。

HSP砂輪規格

粒度		尺寸	機台類型
#320	#1200	6" - 20" 橫軸砂輪	橫軸平面研磨機
#600	#1500		
#800	#2000		
#1000	#3000	6" - 14" 立軸砂輪	立式減薄機

■ 尺寸可依實際加工機台客製

HSP 加工實例

HSP加工載板



砂輪規格	HSP
研磨類型	橫軸平面研磨 (尺寸可依機台與工件客製化)
應用	含銅量較高之載板(Cu>50%)
材質	銅 + EMC
效果	自銳性佳不沾黏，良好的面粗與低阻抗，減少工件損傷提高良率， Ra < 0.3um

砂輪規格 HSP

砂輪尺寸 (mm) 355x75x127 砂輪轉速 30-32 m/s

橫送速度 30 m/min

進刀量 (粗磨) 7um (中磨) 4um (細磨) 2um

COMPANY INFORMATION

嘉寶自然工業股份有限公司

詳細資訊請洽營業人員：

聯絡資訊：

TEL : 02-2679-3461

FAX : 02-2679-4561

地址：新北市鶯歌區福安街一號

線上服務：

官網：www.carbo.com.tw

E-mail：webmaster@carbo.com.tw



■ 使用砂輪時，請嚴守正確使用規範並謹慎操作以維護自身安全。

